

삼성전기, AI 서버부품 강화… LG이노텍, 로봇센싱 영토 확장

m-커버스토리

中 내수·세트산업 업고 고부가 진격
AI용 MLCC·FC-BGA까지 추격

삼성전기, 글로벌 빅테크 공급 확대
LG이노텍, TDK 손잡고 센싱 개발

美 규제 강화로 비중국 수요 부상
기술격차 유지·고객 다변화가 관건

중국 전자부품 업체들이 범용 제품을 넘어 인공지능(AI)·전장 등 고부가 시장으로 빠르게 영역을 넓히고 있다. 거대한 내수시장과 스마트폰·전기차 등 자국 세트업체의 성장을 발판으로 생산 경험과 기술력을 쌓은 영향이다. 삼성전기와 LG이노텍은 AI·전장·로봇 등 기술 난도가 높은 제품을 중심으로 초격차 경쟁력 확보에 사활을 걸고 있다.

◆中 세트산업 성장에 부품업체도 몸집 키워

중국은 스마트폰과 가전은 물론 전기차와 데이터센터 등 전자부품 수요가 많은 산업에서 큰 시장을 형성하고 있다.

특히 전기차와 AI 산업의 성장은 부품 수요의 양뿐 아니라 종류도 바꾸고 있다. 전기차에는 스마트폰보다 많은 MLCC가 필요하고, AI 서버 역시 높은 소비전력에 대응하기 위해 고용량·고신뢰성 MLCC를 사용한다. AI 가속기와 서버 중앙처리장치(CPU)의 성능이 높아지면서 고다층·대



삼성전기 수원사업장 전경.

/삼성전기

면적 FC-BGA 수요도 증가하고 있다.

중국 정부의 첨단산업 자립 정책도 현지 부품업체의 성장을 뒷받침하고 있다. 중국은 올해 확정된 제15차 5개년 계획(2026~2030년)에서 전자정보 산업의 전 산업망 혁신을 추진하고 핵심 부품·전자 부품·전용 소재의 기술 개발을 강화하기로 했다.

다만 중국 업체들이 아직 고부가 부품 시장에서 한국·일본 업체와 대등한 수준의 경쟁력을 갖췄다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다. AI 서버용 MLCC와 FC-BGA 등은 높은 수율과 신뢰성이 요구되는 데다 글로벌 고객사의 장기간 인증도 거쳐야 하기 때문이다. 그럼에도 중국 업체들은 자국 스마트폰·전기차·AI 기업을

고객사로 확보해 양산 경험을 축적할 수 있다는 특별한 강점이 있다.

◆삼성전기, AI·전장용 고부가 제품으로 격차 유지

이같은 상황에서 삼성전기는 범용 제품보다 기술 진입장벽이 높은 AI와 전장용 부품 비중을 높이고 있다. MLCC에서는 AI 서버용 초고용량·고온·고전압 제품 공급을 확대하는 중이다. AI 가속기의 연산 성능과 소비전력이 높아질수록 안정적인 전력 공급을 위한 MLCC의 성능도 중요해지기 때문이다.

삼성전기는 지난달 30일 2분기 실적발표에서 글로벌 하이퍼스케일러와 주요 반도체 업체 등 10여개 고객사와 MLCC 장기공급계약(LTA)을 체결했다고 밝혔다.

추가 계약을 요청한 고객사와도 협의를 진행 중이다. 회사는 AI 서버용 최선단 MLCC의 경우 높은 용량과 내열·내압 성능, 신뢰성이 요구돼 공급 가능한 업체가 제한적이라고 설명했다.

FC-BGA에서도 AI용 제품 비중을 높이고 있다. 삼성전기는 올해 2분기 신규 글로벌 빅테크 고객사에 AI 데이터센터 네트워크용 FC-BGA 공급을 시작했다. 3분기에는 글로벌 빅테크 고객사의 신규 AI 가속기와 서버 CPU용 제품 양산을 확대할 예정이다. AI 데이터센터용 고부가 기관 수요에 대응해 국내의 생산능력도 늘릴 계획이다.

◆카메라에서 '로봇의 눈'으로… LG이노텍, 신사업 '박차'

LG이노텍은 스마트폰카메라모듈에서 확보한 광학 기술을 전장과 로봇으로 확장하고 있다. 스마트폰 특정 고객사에 대한 높은 매출 의존도를 낮추는 동시에 성장성이 높은 신규 시장을 확보하기 위해서다.

로봇 부품에서는 비전 센싱을 중심으로 사업을 넓히고 있다. LG이노텍은 지난달 일본 TDK와 로봇용 비전·촉각 센싱 기술 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 양사는 카메라모듈과 TDK의 센서 기술을 결합한 비전 센싱 모듈과 로봇의 접촉 정보를 감지하는 촉각 센싱 모듈을 공동 개발해 2027년 출시한다는 목표다.

생산 기반도 확대하고 있다. LG이노텍은 올해 베트남 반도체기판 공장 증설에 착수했다. 신공장은 2027년 5월 준공을 목

표로 하며 RF-SiP와 FC-CSP, FC-BGA 등을 생산할 예정이다. 앞서 베트남 하이퐁에는 약 1조3000억원을 투자해 카메라모듈 V3 신공장을 구축했고 지난해 가동을 시작했다.

◆미중 갈등에 공급망 재편… '비중국' 수요는 기회

미중 갈등에 따른 공급망 변화는 국내 업체에 새로운 변수가 되고 있다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 지난달 외국산 첨단 로봇을 국가안보 위험 장비 목록인 '커버드 리스트'에 추가했다. 대상은 특정 국가로 한정되지 않았지만 업계에서는 중국산 로봇의 미국 시장 진입을 제한하는 효과를 것으로 보고 있다.

미국의 규제 강화는 로봇 완제품뿐 아니라 부품 공급망에도 영향을 미칠 전망이다. LG이노텍은 휴머노이드용 비전 센싱 모듈 사업을 확대하고 있으며 삼성전기도 연내 휴머노이드용 카메라모듈 초도 양산을 추진하고 있다. 중국산 로봇의 미국 시장 진입이 제한되면서 국내 업체들도 북미 고객사 확보에 나서는 모습이다.

업계 관계자는 “중국 업체들의 기술 추격과 미중 갈등에 따른 공급망 재편이 동시에 진행되면서 부품업체의 사업 환경도 빠르게 달라지고 있다”며 “국내 업체들은 고부가 제품의 기술 격차를 유지하는 동시에 고객사와 생산지점을 다변화해 특정 시장에 대한 의존도를 낮출 필요가 있다”고 말했다.

/차현정 기자

hyeon@metroseoul.co.kr



metro

윤홍근 BBQ 회장, 30년 경영 철학 공유

“현실에 안주하면 성장 없다”

HDI CEO 서머포럼 연사로 강연
외환위기 등 위기 극복 경험 공유
황금올리브·치킨대학 성장 기반 마련
57개국 800여개 매장 글로벌 확장

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 국내 리더들을 만난 자리에서 불확실한 경영환경을 돌파할 핵심 무기로 ‘안주하지 않는 선택’과 ‘끊임없는 개혁’을 제시했다.

제너시스BBQ 그룹은 윤홍근 회장이 지난 20일 강원도 강릉시 탑스텐 호텔에서 열린 ‘제43회 2026 인간개발연구원(HDI) CEO 서머포럼’에 연사로 나서 ‘위기를 기회로, 세계를 향한 끊임없는 도전’을 주제로 강연을 진행했다고 23일 밝혔다.

국내 주요 기업 및 기관 최고경영자 130여명이 참석한 이번 포럼에서 윤 회장은 창립 이후 31년간 거친 외환위기와 조류인플루엔자(AI) 등 역경의 순간들을 조명했다. 그는 지난 과정이 단순한 성과의 나열이 아닌, 고비 때마다 이뤄진 과감한 선택의 연속이었다고 자평했다. 이 과정에서 2005년 황금올리브치킨을 출시하고 치킨대학을 설립하는 등 제품·품질관리 시스템 구축이 브랜드 성장의 기틀이 됐다고 덧붙였다.

이어 기업의 외형 확장보다 지속 가능한 경쟁력을 확보하는 것이 생존의 핵심 요소라고 강조했다. 이러한 개혁 기조는 해외 시장 진출로 이어졌다. BBQ는 지역별 소비 문화와 식습관에 맞춘 현지화 기



제너시스BBQ 그룹은 윤홍근 회장이 지난 20일 강원도 강릉시 탑스텐 호텔에서 열린 ‘제43회 2026 인간개발연구원(HDI) CEO 서머포럼’에 연사로 나서 ‘위기를 기회로, 세계를 향한 끊임없는 도전’을 주제로 강연을 진행했다고 23일 밝혔다. 사진은 윤홍근 회장의 강연 모습.

/제너시스BBQ 그룹

법을 도입했다. 현재 북미와 중남미, 동남아, 중앙아시아 등 전 세계 57개국에서 800여개 매장을 운영 중이다.

윤 회장은 남들이 만들어 놓은 길만 따라가서는 시장의 주인이 될 수 없다며 기술 과잉 시대일수록 기업이 제공해야 할 본질적 가치에 집중해야 한다고 역설했다. 그는 “앞으로도 BBQ는 현실에 안주하지 않고 세계 시장을 향해 끊임없이 도전하며 K-푸드의 경쟁력을 세계에 알리는 글로벌 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.

/김수정 수습기자 kcrystal@



metro

SK하이닉스, 94조 투자·환원… 남는 현금 150조 전망

용인·청주 생산시설에 54조 투자
40조 자사주 매입해 전량 소각

SK하이닉스가 94조원 규모의 투자와 주주환원에 나선 가운데 올해 설비투자 등을 제외하고 남는 잉여현금흐름이 150조원을 웃돌 것이라는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 메모리 호황으로 현금 창출력이 크게 높아지면서 대규모 증설과 주주환원을 동시에 확대할 여력도 커지고 있다.

23일 SK하이닉스와 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 회사는 이달 용인과 청주 생산시설에 총 54조3000억원을 투자하기로 한 데 이어 40조원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각하기로 했다. 두 결정의 명목 규모를 합하면 94조3000억원이다.

그럼에도 SK하이닉스가 벌어들이는 현금 투자와 주주환원 규모를 크게 웃돌 전망이다. 일본계 글로벌 투자은행(IB) 노무라는 SK하이닉스의 올해 잉여현금흐름을 156조원으로 전망했다. 내년에는 318조원으로 올해보다 두 배 이상 늘어날 것으로 내다봤다. 잉여현금흐름은 영업활동으로 벌어들이는 현금에서 설비투자 등에 필요한 자금을 제외하고 남는 금액이다.

다만 94조3000억원이 올해 한꺼번에 지출되는 것은 아니다. 용인 Y2와 청주 M17에 들어가는 54조3000억원은 2031년까지 단계적으로 집행된다. 자사주 매입은 지난 20일 시작해 오는 11월 19일까지 진행된다. 이미 확보한 현금도 상당하다. 2분기 말 현금성 자산은 전분기 말보다 33조6000억원 증가한 88조원으로 집계됐다. 차입금은 7000억원 감소한 18조6000



생성형 AI가 SK하이닉스의 반도체 생산시설 투자와 현금 확대를 형상화한 이미지.

억원으로, 이를 제외한 순현금은 69조4000억원까지 늘었다.

현금 창출력을 끌어올린 것은 사상 최대 실적이다. 2분기 매출은 79조3187억원, 영업이익은 60조5426억원으로 모두 분기 기준 최대치를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 257%, 557% 증가했다. 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가 제품 판매 확대가 실적을 뒷받침했다.

늘어난 현금을 바탕으로 주주환원도 확대하고 있다. SK하이닉스는 지난 19일 40조원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각하기로 했다. 취득 예정 주식은 약 2407만주로 발행주식의 약 3.3%다. 회사에 따르면 국내 상장사의 자사주 취득·소각 사례 가운데 금액 기준 역대 최대 규모다.

향후 주주환원 기준도 높였다. SK하이닉스는 2025년부터 2027년까지 누적 잉여 현금흐름의 50% 이상을 주주환원에 활용하기로 했다. 기존 ‘50% 범위 내’에서 하

한선을 50%로 높인 것이다. 미국계 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 2027년까지 최소 180조원의 추가 주주환원이 가능할 것으로 추산했다. 노무라는 올해와 내년 주주환원 규모를 각각 78조원과 159조원으로 예상했다.

주주환원과 함께 생산시설 투자도 이어간다. SK하이닉스는 지난 7월 용인 반도체 클러스터 Y2에 35조2000억원, 청주 M17에 19조1000억원 등 총 54조3000억원을 투자하기로 했다. Y2와 M17은 각각 D램과 낸드플래시 생산시설로 내년부터 순차적으로 착공한다.

해외 투자도 본격화한다. SK하이닉스는 오는 27일 미국 인디애나주 웨스트라피엣에서 38억7000만달러(약 5조4000억원) 규모의 첨단 패키징 시설 착공식을 열 예정이다. 고대역폭메모리 등 AI용 메모리의 첨단 패키징 생산 시설과 연구개발 시설을 구축한다.

/구남영 기자 koogija_tea@



metro